

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-017

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 豪威集成电路（集团）股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次 2025 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### 一、公司 2025 年度利润分配预案

##### （一）2025 年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 4,045,416,530.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 663,283,212.41 元，资本公积金为 19,927,593,495.86 元。

经第七届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定 2025 年度利润分配预案的议案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

截至 2026 年 3 月 23 日，公司总股本 1,261,074,075 股，以扣除回购专户已回购的 3,921,163 股后的股份数为基数，测算拟分配现金红利总额为 125,715,291.20 元（含税）。

2025 年度公司现金分红（包括 2025 年中期利润分配方案已分配的现金红利 482,193,174.40 元）总额为 607,908,465.60 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交至股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形。相关指标如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	607,908,465.60	503,969,189.98	167,603,477.30
回购注销总额（元）	999,731,817.55	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,045,416,530.33	3,323,242,749.90	555,623,916.73
本年度末母公司报表未分配利润（元）	663,283,212.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,279,481,132.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	999,731,817.55		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,641,427,732.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,279,212,950.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	86.29%		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：2025 年 8 月 7 日，公司已注销存放于公司回购专用证券账户中的 11,213,200 股股份，并相应减少注册资本，对应支付的总金额为人民币 999,731,817.55 元。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 4,045,416,530.33 元，2025 年年度分红拟分配的现金红利总额为 607,908,465.60 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 15.03%，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

公司是主要从事芯片设计业务的 Fabless 芯片设计公司。公司所处的半导体设计行业为技术密集及资金密集型产业，具有技术迭代迅速、研发投入巨大、产品生命周期较短的特点。基于此，公司高度重视自主知识产权的技术与产品研发，构建了以客户需求为导向的研发模式，持续加大在各产品领域的研发投入，为产品升级与新产品的研发提供充分保障。2025 年度，公司半导体设计销售业务研发投入金额约为 36.80 亿元，占公司半导体设计销售业务收入的 15.46%，较上年增长 13.38%。

目前公司处于扩张成长阶段，公司半导体设计业务聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案、模拟解决方案三大核心业务板块，2025 年度公司实现营业收入 288.55 亿元，较 2024 年增加 12.14%；公司实现归属于母公司股东的净利润 40.45 亿元，较 2024 年增长 21.73%。随着公司业务规模持续扩大，公司对资金的需求日益增加，通过持续的技术创新、充足的资本投入及坚实的人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

### （二）上市公司留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将主要用于加大在图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系的研发投入、人才资源建设、扩大市场规模以及补充公司日常流动资金等方面。研发投入是公司作为半导体设计公司长期发展的立身之本，公司将通过加大自主研发、合作研发等方式保持公司的技术优势，增强公司在知识产权和技术方面的优势，扩展公司产品组合，以持续提升市场渗透率；在市场拓展方面，公司计划深化目标市场布局、扩大客户群并提升在各个领域的市场份额。通过上述举措，公司将不断夯实长期竞争壁垒，提升持续盈利能力，从而为股东创造更为坚实的长期投资价值。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司在利润分配方案决策过程中,严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,为中小股东参与决策提供充分便利。公司将为股东会提供网络投票方式,为中小股东参与表决提供便利条件,同时该事项对中小投资者单独计票,充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将聚焦主业,努力提升经营业绩与质量,以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平,并严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定,综合考虑利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,兼顾分红政策的连续性和稳定性,努力提升投资者回报水平。

### 三、提请股东会授权董事会确定2026年度中期利润分配方案

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司盈利情况和资金需求状况,拟制定2026年中期利润分配方案,其中现金分红金额不超过2026年当期归属于上市公司股东净利润,并提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配条件的情况下制定2026年中期利润分配方案并办理中期利润分配相关事宜。

### 四、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第十三次会议,公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交至公司股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

## 五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交至公司股东会审议。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026年3月31日